

電子回路基板生産動向(2004年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 16年 1月 実績	電子回路基板	2,074	67,953	107.3	115.5	2,074	67,953	107.3	115.5
	リジッドプリント配線板	1,332	40,176	98.7	108.8	1,332	40,176	98.7	108.8
	片面プリント配線板	388	1,897	87.8	99.1	388	1,897	87.8	99.1
	両面プリント配線板	454	8,965	102.5	104.0	454	8,965	102.5	104.0
	多層プリント配線板(4層)	258	8,668	97.4	98.2	258	8,668	97.4	98.2
	多層プリント配線板(6-8層)	100	8,147	103.1	107.2	100	8,147	103.1	107.2
	多層プリント配線板(10層以上)	23	3,707	127.8	186.7	23	3,707	127.8	186.7
	ビルドアップ多層配線板	110	8,792	131.0	109.9	110	8,792	131.0	109.9
	フレキシブルプリント配線板	539	12,778	114.9	110.6	539	12,778	114.9	110.6
	片面フレキシブル配線板	317	5,539	114.0	109.6	317	5,539	114.0	109.6
	両面・多層フレキシブル配線板	221	7,239	115.7	111.4	221	7,239	115.7	111.4
	モジュール基板	203	14,920	178.1	144.9	203	14,920	178.1	144.9
	リジッド系モジュール基板	51	8,953	196.2	151.4	51	8,953	196.2	151.4
その他のモジュール基板	152	5,967	170.8	136.1	152	5,967	170.8	136.1	
その他の電子回路基板	1	79	100.0	179.5	1	79	100.0	179.5	
平成 16年 2月 実績	電子回路基板	2,130	67,605	110.4	115.0	4,206	135,558	108.9	115.2
	リジッドプリント配線板	1,380	40,533	101.9	108.9	2,714	80,709	100.4	108.8
	片面プリント配線板	397	1,950	89.2	101.7	785	3,847	88.5	100.4
	両面プリント配線板	471	9,036	105.8	105.6	925	18,001	104.2	104.8
	多層プリント配線板(4層)	263	8,916	100.0	97.5	521	17,584	98.7	97.9
	多層プリント配線板(6-8層)	119	8,334	122.7	108.2	219	16,481	112.9	107.7
	多層プリント配線板(10層以上)	22	3,511	115.8	163.5	45	7,218	121.6	174.6
	ビルドアップ多層配線板	109	8,786	128.2	113.4	219	17,578	129.6	111.6
	フレキシブルプリント配線板	547	12,943	122.6	118.7	1,085	25,721	118.6	114.5
	片面フレキシブル配線板	322	5,788	121.1	119.6	639	11,327	117.5	114.5
	両面・多層フレキシブル配線板	225	7,155	125.0	118.0	446	14,394	120.2	114.6
	モジュール基板	201	14,035	157.0	132.4	405	28,955	167.4	138.6
	リジッド系モジュール基板	49	7,971	204.2	143.6	100	16,924	200.0	147.7
その他のモジュール基板	153	6,064	147.1	120.1	305	12,031	158.0	127.6	
その他の電子回路基板	1	94	100.0	114.6	2	173	100.0	137.3	
平成 16年 3月 実績	電子回路基板	2,318	76,023	113.6832	113.8171	6,522	211,581	110.5	114.7197
	リジッドプリント配線板	1,511	46,047	109.4135	118.4458	4,224	126,756	103.4	112.1367
	片面プリント配線板	426	2,037	90.06342	105.9282	1,211	5,884	88.97869	102.2415
	両面プリント配線板	529	10,276	123.31	115.4	1,453	28,277	110.3265	108.3991
	多層プリント配線板(4層)	294	10,229	112.2137	119.9883	815	27,813	103.0341	104.9745
	多層プリント配線板(6-8層)	118	9,646	114.5631	119.396	336	26,127	113.1313	111.7637
	多層プリント配線板(10層以上)	23	3,825	121.0526	171.5	68	11,043	121.4286	173.6
	ビルドアップ多層配線板	122	10,034	128.4211	108.8759	340	27,612	129.2776	110.6206
	フレキシブルプリント配線板	587	13,997	117.6353	111.8775	1,673	39,718	118.3168	113.5806
	片面フレキシブル配線板	341	5,874	118.0	109.5896	980	17,201	117.6471	112.7491
	両面・多層フレキシブル配線板	247	8,123	117.619	113.5925	693	22,517	119.2771	114.2241
	モジュール基板	217	15,818	138.2166	103.3654	622	44,773	155.8897	123.6926
	リジッド系モジュール基板	55	9,718	127.9	94.82826	154	26,642	165.5914	122.7176
その他のモジュール基板	163	6,100	143.0	120.6726	467	18,131	152.1173	125.1536	
その他の電子回路基板	2	161	200.0	154.8077	4	334	133.3333	145.2174	
平成 16年 4月 実績	電子回路基板	2,248	69,956	113.1	116.1	8,770	281,537	111.2	115.1
	リジッドプリント配線板	1,472	44,121	109.9	111.1	5,696	170,877	105.0	111.9
	片面プリント配線板	414	1,999	95.8	98.4	1,625	7,883	90.6	101.2
	両面プリント配線板	521	10,182	122.6	118.1	1,974	38,459	113.3	110.8
	多層プリント配線板(4層)	279	9,192	104.9	92.7	1,094	37,005	103.5	101.6
	多層プリント配線板(6-8層)	119	9,014	108.2	103.5	455	35,141	111.8	109.5
	多層プリント配線板(10層以上)	22	3,832	122.2	163.2	90	14,875	121.6	170.8
	ビルドアップ多層配線板	116	9,902	130.3	122.4	456	37,514	129.5	113.5
	フレキシブルプリント配線板	573	13,373	111.5	107.0	2,246	53,091	116.5	111.8
	片面フレキシブル配線板	341	5,930	116.0	115.0	1321	23,131	117.2	113.3
	両面・多層フレキシブル配線板	232	7,443	105.5	101.3	925	29,960	115.5	110.7
	モジュール基板	200	12,279	152.7	156.3	822	57,052	155.1	129.5
	リジッド系モジュール基板	34	5,989	212.5	184.5	188	32,631	172.5	130.8
その他のモジュール基板	166	6,290	144.3	136.5	633	24,421	150.0	127.9	
その他の電子回路基板	3	183	150.0	93.8	7	517	140.0	121.6	

電子回路基板生産動向(2004年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 16年 5月 実績	電子回路基板	2,112	65,705	104.2	102.9	10,882	347,242	109.8	112.5
	リジッドプリント配線板	1,349	39,475	96.3	99.3	7,045	210,352	103.2	109.3
	片面プリント配線板	400	2,055	84.9	102.1	2,025	9,938	89.4	101.4
	両面プリント配線板	459	9,107	104.8	103.6	2,433	47,566	111.6	109.3
	多層プリント配線板(4層)	263	8,591	100.4	84.6	1,357	45,596	102.9	97.9
	多層プリント配線板(6-8層)	115	8,651	102.7	108.9	570	43,792	109.8	109.4
	多層プリント配線板(10層以上)	19	3,374	105.6	144.3	109	18,249	118.5	165.2
	ビルドアップ多層配線板	92	7,697	92.0	90.4	548	45,211	121.2	108.8
	フレキシブルプリント配線板	551	12,984	112.9	105.0	2,797	66,075	115.8	110.4
	片面フレキシブル配線板	325	5,593	110.2	105.5	1,646	28,724	115.8	111.7
	両面・多層フレキシブル配線板	226	7,391	117.7	104.6	1,151	37,351	115.9	109.5
	モジュール基板	210	13,097	154.4	113.4	1,032	70,149	155.0	126.2
	リジッド系モジュール基板	32	6,621	100.0	95.2	220	39,252	156.0	123.0
	その他のモジュール基板	178	6,476	171.2	141.1	811	30,897	154.2	130.4
その他の電子回路基板	2	149	100.0	72.3	9	666	128.6	105.5	
平成 16年 6月 実績	電子回路基板	2,256	71,915	106.8	111.0	13,138	419,157	109.2	112.3
	リジッドプリント配線板	1,435	42,414	100.6	105.1	8,480	252,766	102.8	108.5
	片面プリント配線板	433	2,487	92.3	125.0	2,458	12,425	89.9	105.4
	両面プリント配線板	477	9,862	103.2	106.2	2,911	57,428	110.2	108.8
	多層プリント配線板(4層)	278	9,010	104.5	97.2	1,635	54,606	103.2	97.8
	多層プリント配線板(6-8層)	119	8,423	101.7	97.9	689	52,215	108.3	107.4
	多層プリント配線板(10層以上)	23	3,820	127.8	152.7	133	22,069	120.9	162.9
	ビルドアップ多層配線板	105	8,812	112.9	101.1	653	54,023	119.8	107.4
	フレキシブルプリント配線板	600	14,332	110.9	109.1	3,397	80,407	114.9	110.2
	片面フレキシブル配線板	340	5,856	105.3	103.1	1,985	34,580	113.7	110.1
	両面・多層フレキシブル配線板	261	8,476	119.7	113.7	1,412	45,827	116.6	110.2
	モジュール基板	217	14,935	150.7	134.7	1,248	85,084	154.1	127.6
	リジッド系モジュール基板	38	8,442	135.7	138.9	257	47,694	152.1	125.6
	その他のモジュール基板	180	6,493	156.5	129.6	991	37,390	154.4	130.3
その他の電子回路基板	4	234	200.0	108.8	13	900	144.4	106.4	
平成 16年 7月 実績	電子回路基板	2,261	70,208	101.5	100.6	15,399	489,365	108.0	110.4
	リジッドプリント配線板	1,469	42,888	97.5	100.5	9,949	295,654	101.9	107.3
	片面プリント配線板	449	2,506	88.4	117.8	2,907	14,931	89.7	107.3
	両面プリント配線板	499	10,160	105.1	110.4	3,410	67,588	109.4	109.0
	多層プリント配線板(4層)	274	8,966	95.8	85.3	1,909	63,572	102.0	95.8
	多層プリント配線板(6-8層)	115	8,411	96.6	94.7	804	60,626	106.5	105.4
	多層プリント配線板(10層以上)	25	3,851	147.1	150.5	158	25,920	124.4	160.9
	ビルドアップ多層配線板	106	8,994	105.0	95.5	759	63,017	117.5	105.6
	フレキシブルプリント配線板	585	14,341	106.0	105.7	3,982	94,748	113.5	109.5
	片面フレキシブル配線板	334	5,699	100.0	93.1	2,319	40,279	111.5	107.4
	両面・多層フレキシブル配線板	251	8,642	114.6	116.1	1,663	54,469	116.3	111.1
	モジュール基板	203	12,699	122.3	95.5	1,451	97,783	148.7	122.3
	リジッド系モジュール基板	31	6,349	83.8	81.7	288	54,043	139.8	118.1
	その他のモジュール基板	172	6,350	133.3	115.1	1,163	43,740	150.8	127.8
その他の電子回路基板	4	280	200.0	134.6	17	1,180	154.5	112.0	
平成 16年 8月 実績	電子回路基板	2,055	65,180	107.0	107.7	17,454	554,545	107.9	110.1
	リジッドプリント配線板	1,334	39,134	103.9	107.5	11,283	334,788	102.2	107.3
	片面プリント配線板	360	1,724	85.9	94.2	3,267	16,655	89.3	105.8
	両面プリント配線板	517	10,305	120.0	124.5	3,927	77,893	110.7	110.8
	多層プリント配線板(4層)	246	8,452	102.1	96.9	2,155	72,024	102.0	96.0
	多層プリント配線板(6-8層)	96	7,525	106.7	107.0	900	68,151	106.5	105.6
	多層プリント配線板(10層以上)	20	3,195	166.7	154.7	178	29,115	128.1	160.2
	ビルドアップ多層配線板	96	7,933	106.7	93.4	855	70,950	116.2	104.0
	フレキシブルプリント配線板	532	13,059	108.6	107.3	4,514	107,807	112.9	109.2
	片面フレキシブル配線板	303	5,338	101.0	98.1	2,622	45,617	110.2	106.2
	両面・多層フレキシブル配線板	229	7,721	120.5	114.8	1,892	62,190	116.8	111.6
	モジュール基板	185	12,694	129.4	107.7	1,636	110,477	146.2	120.4
	リジッド系モジュール基板	35	7,078	112.9	106.3	323	61,121	136.3	116.6
	その他のモジュール基板	150	5,616	133.9	109.4	1,313	49,356	148.7	125.4
その他の電子回路基板	4	293	200.0	177.6	21	1,473	161.5	120.8	

電子回路基板生産動向(2004年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 16年 9月 実績	電子回路基板	2,167	68,608	96.5	96.4	19,621	623,153	106.5	108.4
	リジッドプリント配線板	1,425	42,919	94.7	97.3	12,708	377,707	101.3	106.1
	片面プリント配線板	373	1,826	77.2	89.6	3,640	18,481	87.9	103.9
	両面プリント配線板	553	11,082	110.8	114.3	4,480	88,975	110.7	111.3
	多層プリント配線板(4層)	267	8,987	94.3	83.9	2,422	81,011	101.1	94.5
	多層プリント配線板(6-8層)	108	8,930	98.2	102.0	1,008	77,081	105.4	105.2
	多層プリント配線板(10層以上)	21	3,370	116.7	125.7	199	32,485	125.9	155.8
	ビルドアップ多層配線板	103	8,724	92.0	85.2	958	79,674	113.0	101.6
	フレキシブルプリント配線板	564	13,611	97.7	96.8	5,078	121,418	111.0	107.7
	片面フレキシブル配線板	317	5,572	93.2	92.2	2,939	51,189	108.1	104.5
	両面・多層フレキシブル配線板	247	8,039	104.7	100.4	2,139	70,229	115.2	110.2
	モジュール基板	173	11,739	106.1	91.2	1,809	122,216	141.1	116.8
	リジッド系モジュール基板	33	6,421	94.3	89.6	356	67,542	130.9	113.3
その他のモジュール基板	140	5,318	109.4	93.3	1,453	54,674	143.7	121.4	
その他の電子回路基板	5	339	250.0	233.8	26	1,812	185.7	132.8	
平成 16年 10月 実績	電子回路基板	2,050	65,193	88.1	89.8	21,671	688,346	104.5	106.3
	リジッドプリント配線板	1,381	39,930	87.8	88.7	14,089	417,637	99.8	104.1
	片面プリント配線板	367	1,820	74.1	84.8	4,007	20,301	86.4	101.9
	両面プリント配線板	555	10,840	107.1	111.7	5,035	99,815	110.3	111.3
	多層プリント配線板(4層)	239	8,108	79.7	76.5	2,661	89,119	98.7	92.5
	多層プリント配線板(6-8層)	100	7,826	89.3	86.9	1,108	84,907	103.7	103.2
	多層プリント配線板(10層以上)	23	3,174	121.1	101.8	222	35,659	125.4	148.8
	ビルドアップ多層配線板	98	8,162	76.0	78.1	1,056	87,836	108.1	98.8
	フレキシブルプリント配線板	503	12,938	87.0	86.6	5,581	134,356	108.3	105.2
	片面フレキシブル配線板	268	5,156	83.0	86.0	3,207	56,345	105.4	102.4
	両面・多層フレキシブル配線板	235	7,782	92.2	87.0	2,374	78,011	112.5	107.3
	モジュール基板	163	12,044	93.1	96.5	1,972	134,260	135.3	114.6
	リジッド系モジュール基板	34	6,802	103.0	102.4	390	74,344	127.9	112.2
その他のモジュール基板	129	5,242	90.8	89.9	1,582	59,916	137.2	117.8	
その他の電子回路基板	4	281	400.0	228.5	30	2,093	200.0	140.8	
平成 16年 11月 実績	電子回路基板	2,104	67,233	96.8	96.3	23,775	755,579	103.7	105.3
	リジッドプリント配線板	1,396	40,732	97.1	94.2	15,485	458,369	99.5	103.2
	片面プリント配線板	368	1,728	83.4	89.3	4,375	22,029	86.1	100.8
	両面プリント配線板	547	10,226	114.9	111.0	5,582	110,041	110.8	111.3
	多層プリント配線板(4層)	247	8,799	90.8	89.6	2,908	97,918	98.0	92.2
	多層プリント配線板(6-8層)	110	8,731	104.8	102.0	1,218	93,638	103.8	103.1
	多層プリント配線板(10層以上)	18	3,045	85.7	92.6	240	38,704	121.2	142.0
	ビルドアップ多層配線板	105	8,203	86.1	78.7	1,161	96,039	105.6	96.7
	フレキシブルプリント配線板	520	12,975	91.9	91.8	6,101	147,331	106.7	103.9
	片面フレキシブル配線板	265	4,922	83.6	91.2	3,472	61,267	103.3	101.4
	両面・多層フレキシブル配線板	255	8,053	102.4	92.2	2,629	86,064	111.4	105.7
	モジュール基板	185	13,284	110.1	107.6	2,157	147,544	132.7	114.0
	リジッド系モジュール基板	36	7,428	102.9	110.7	426	81,772	125.3	112.1
その他のモジュール基板	148	5,856	111.3	103.9	1,730	65,772	134.5	116.4	
その他の電子回路基板	3	242	300.0	252.1	33	2,335	206.3	147.5	
平成 16年 12月 実績	電子回路基板	1,991	63,022	92.5	90.1	25,767	818,601	102.8	104.0
	リジッドプリント配線板	1,276	38,649	91.9	89.7	16,761	497,018	98.9	102.0
	片面プリント配線板	324	1,637	80.2	89.9	4,700	23,666	85.7	99.9
	両面プリント配線板	524	10,286	111.0	106.8	6,106	120,327	110.8	110.9
	多層プリント配線板(4層)	229	7,884	83.6	79.3	3,136	105,802	96.7	91.1
	多層プリント配線板(6-8層)	88	7,847	83.8	89.6	1,305	101,485	102.1	101.9
	多層プリント配線板(10層以上)	19	3,264	90.5	94.1	259	41,968	118.3	136.6
	ビルドアップ多層配線板	92	7,731	82.1	81.6	1,254	103,770	103.6	95.4
	フレキシブルプリント配線板	525	12,588	90.4	87.9	6,627	159,919	105.2	102.4
	片面フレキシブル配線板	277	5,281	83.9	91.3	3,749	66,548	101.6	100.6
	両面・多層フレキシブル配線板	248	7,307	98.8	85.6	2,878	93,371	110.3	103.8
	モジュール基板	186	11,535	101.6	92.7	2,343	159,079	129.7	112.1
	リジッド系モジュール基板	29	5,465	82.9	83.2	455	87,237	121.3	109.7
その他のモジュール基板	157	6,070	106.1	103.5	1,888	71,842	131.8	115.2	
その他の電子回路基板	3	250	300.0	240.4	36	2,585	211.8	153.2	

接続係数について

### 電子回路基板生産動向(2004年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比	
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)

平成16年2月以前の数値を使用して前年同月比を求める場合、下記の係数で前年同月比を乗じて計算して下さい

	数 量	金 額
電子回路基板	1.045	1.028
リジッドプリント配線板	1.062	1.040
両面プリント配線板	1.077	1.054
多層プリント配線板(4層)	1.146	1.085
多層プリント配線板(6~8層)	1.052	
フレキシブルプリント配線板		
両面・多層フレキシブル配線板	1.030	

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2005/4/15 補正值発表 / 2005/4/19 JPCA作成)

社団法人日本プリント回路工業会  
Japan Printed Circuit Association